附件3

表1 XX区重点集成电路设计企业申请减免所得税汇总表—《若干政策》第（三）、（七）条

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业及联系人基本信息** | **注册地** | **汇算清缴年度人员情况（具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系）（单位：人）** | **年度应纳税所得额（单位：万元）** | **汇算清缴年度研究开发费用（单位：万元）** | **汇算清缴年度集成电路设计销售（营业）收入（单位：万元）** | **知识产权** | **是否为补报2021年** |
| 序号 | 企业联系人及电话 | 注册地址 | 具有本科及以上学历的月平均职工人数 | 月平均职工人数 | 月平均研发人员数 | 汇算清缴 | 研究开发费用总额 | 企业收入总额 | 集成电路设计销售（营业）收入 | 集成电路自主设计销售（营业）收入 | 企业拥有与集成电路产品设计相关的发明专利、布图设计登记、软件著作权合计数 | 如补报2021年，需填写2020年数据 |

表2 XX区重点集成电路生产企业申请减免所得税汇总表—《若干政策》第（一）条

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业及联系人基本信息** | **注册地** | **汇算清缴年度人员情况（具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系）（单位：人）** | **年度应纳税所得额（单位：万元）** | **汇算清缴年度研究开发费用（单位：万元）** | **汇算清缴年度集成电路制造销售（营业）收入（单位：万元）** | **知识产权** | **是否为补报2021年** |
| 序号 | 企业名称 | 企业联系人及电话 | 注册地址 | 具有本科及以上学历的月平均职工人数 | 月平均职工人数 | 月平均研发人员数 | 汇算清缴 | 研究开发费用总额 | 企业收入总额 | 集成电路制造销售（营业）收入 | 企业拥有相关的发明专利数量 | 如补报2021年，需填写2020年数据 |

表3 XX区重点软件企业申请减免所得税汇总表—《若干政策》第（三）、（七）条

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业及联系人基本信息** | **注册地** | **汇算清缴年度人员情况（具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系）（单位：人）** | **汇算清缴年度研究开发费用（单位：万元）** | **汇算清缴年度软件产品开发销售及相关信息技术服务（营业）收入（单位：万元）** | **知识产权** | **是否为补报2021年** |
| 序号 | 企业名称 | 企业联系人及电话 | 注册地址 | 具有本科及以上学历的月平均职工人数 | 月平均职工人数 | 月平均研发人员数 | 研究开发费用总额 | 中国境内研究开发费用 | 企业收入总额 | 软件产品开发销售及相关信息技术服务（营业）收入 | 领域内软件产品开发及相关信息技术服务销售（营业）收入 | 企业拥有相关的发明专利、软件著作权合计数 | 如补报2021年，需填写2020年数据 |

表4 XX区先进封装测试企业申请免征进口关税汇总表—《若干政策》第(六)条

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业及联系人基本信息** | **注册地** | **汇算清缴年度企业先进封装测试规划产能情况** | **是否为补报2021年** |
| 序号 | 企业名称 | 企业联系人及电话 | 注册地址 | 企业先进封装测试（晶圆级封装、系统级封装、2.5维和3.5维封装）规划产能 | 总规划产能 | 企业先进封装测试（晶圆级封装、系统级封装、2.5维和3.5维封装）规划产能占总规划产能比例 | 如补报2021年，需填写2020年数据 |

表5 XX区集成电路生产企业申请免征进口关税汇总表—

《若干政策》第（六）条和财关税〔2021〕4号文提及的集成电路生产企业

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业及联系人基本信息** | **注册地及企业性质** | **资质认证** | **是否为补报2021年** |
| 序号 | 企业名称 | 企业联系人及电话 | 企业性质是否符合《若干政策》第（六）条、财关税【2021】4号文提及的生产企业 | 注册地址 | 是否具有保证产品生产的手段和能力 | 如补报2021年，需填写2020年数据 |

表6 XX区集成电路重大项目（制造）企业申请分期缴纳进口环节增值税汇总表

—《若干政策》第(八)条

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业及联系人基本信息** | **集成电路重大项目承建企业条件** | **不同工艺类型芯片制造项目** | **是否为补报2021年** |
| **线宽≤65nm的逻辑电路、存储器项目** | **线宽≤0.25μm的模拟、数模混合、高压、射频、功率、光电集成、图像传感、微机电系统、绝缘体上硅工艺等特色芯片制造项目** | **线宽≤0.5μm的基于化合物集成电路制造项目** |
| 序号 | 企业名称 | 企业联系人及电话 | 是否符合《若干政策》第六条提及的集成电路生产企业 | 固定资产总投资额（单位：万元） | 规划月产能（折合12英寸） | 固定资产总投资额（单位：万元） | 规划月产能（折合8英寸） | 固定资产总投资额（单位：万元） | 规划月产能（折合6英寸） | 如补报2021年，需填写2020年数据 |

表7 XX区集成电路重大项目（封测）企业申请分期缴纳进口环节增值税汇总表—

《若干政策》第(八)条

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业及联系人基本信息** | **集成电路重大项目承建企业条件** | **封装规划年产能** | **是否为补报2021年** |
| 序号 | 企业名称 | 企业联系人及电话 | 是否符合《若干政策》第六条提及的先进封装测试企业 | 固定资产总投资额（单位：万元） | 封装规划年产能（折合8英寸） | 如补报2021年，需填写2020年数据 |